



2007年2月19日

各 位

会 社 名 エルピーダメモリ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 坂本 幸雄  
(コード番号：6665 東証第1部)  
問 合 せ 先 執行役員・CFO 福田 岳弘  
(TEL. 03 - 3281 - 1500(代))

## 広島エルピーダ200mmウェハ処理用装置譲渡に関し基本合意

エルピーダメモリ株式会社(以下、エルピーダ)は、本日、Semiconductor Manufacturing International Corporation (President & CEO: Richard Ru Gin Chang、中文商号: 中芯国际集成电路制造有限公司 以下、SMIC)およびCension Semiconductor Manufacturing Corporation (President & CEO: Zheng, Jin Yuan 以下、Cension)と、エルピーダの生産拠点である広島エルピーダメモリ株式会社(代表取締役社長: 坂本 幸雄 <兼務>、以下、広島エルピーダ)の200mmウェハ処理用装置をCensionへ譲渡することについて基本合意いたしました。  
また、SMICはエルピーダが譲渡した装置群を運営し、生産活動を行います。

### 記

#### 1. 譲渡の理由

先端 DRAM の開発・生産・販売を進めるエルピーダでは、先端プロセスによる微細加工技術の確立に一層注力し、より高速・低消費電力な DRAM の提供を積極的に行っていくことが重要と考えています。

そのために、先端プロセスでの生産を実現する 300mm ウェハラインの生産増強に伴い、200mm ウェハラインのリソースをすみやかに移行させることが必要不可欠であると判断し、このたび 200mm ライン装置を SMIC により生産運営されている Cension へ譲渡することといたしました。

#### 2. 譲渡資産の内容

対象資産：広島エルピーダ 200mm ウェハライン内装置  
所在地：広島県東広島市吉川工業団地 7 番 10 号

#### 3. 譲渡先の概要

商号：Cension Semiconductor Manufacturing Corporation  
(中文商号: 成都成芯半导体制造有限公司)

本社所在地：No.8 Kexin Road, Export Processing Zone (West Area),  
The People's Republic of China  
(中国四川省成都)

代表者：President & CEO Zheng, Jin Yuan

事業内容：SMIC 運営による半導体受託製造(前工程)

当社との関係：なし

4. 譲渡の日程

取締役会決議：2007年2月15日

契約締結：2007年2月19日

物件引渡し：未定

5. 今後の見通し

今後の業績への影響につきましては、契約の詳細決定とともに精査を進めます。

なお、現在、顧客よりオーダーを受けている200mmウェハライン生産製品につきましては、従来同様のサポートを継続いたします。

以上

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

<報道関係からのお問い合わせ先>

エルピーダメモリ株式会社

広報グループ 小林

TEL：03-3281-1648、E-mail：press@elpida.com